

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2014 年 8 月 7 日(07.08.2014)



(10) 国際公開番号

WO 2014/118860 A1

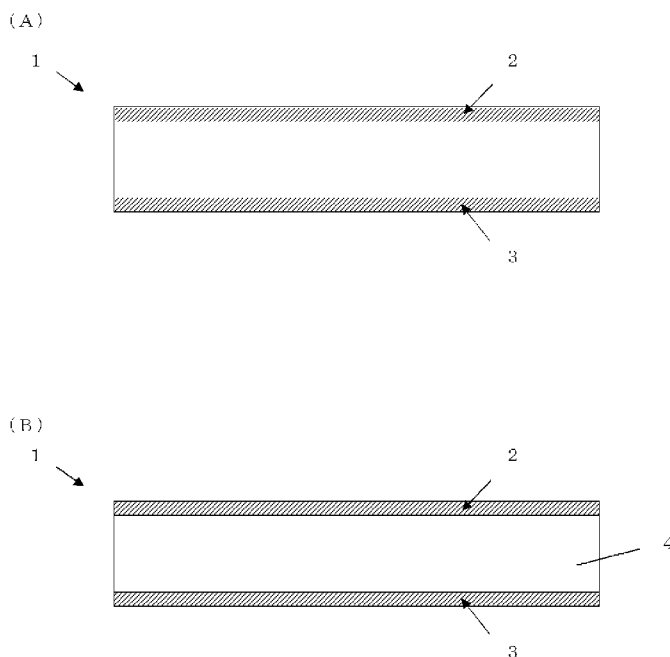
- (51) 国際特許分類:
B24B 37/28 (2012.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2013/007464
- (22) 国際出願日: 2013 年 12 月 19 日(19.12.2013)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2013-014172 2013 年 1 月 29 日(29.01.2013) JP
- (71) 出願人: 信越半導体株式会社 (SHIN-ETSU HAN-
DOTAI CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1000004 東京都千代田
区大手町二丁目 6 番 2 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 佐々木 正直 (SASAKI, Masanao); 〒
9618061 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大
平 1 5 0 番地信越半導体株式会社 白河工場内
Fukushima (JP). 内山 勇雄 (UCHIYAMA, Isao); 〒
9618061 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大
平 1 5 0 番地信越半導体株式会社 白河工場内
Fukushima (JP).
- (74) 代理人: 好宮 幹夫 (YOSHIMIYA, Mikio); 〒
1100005 東京都台東区上野 7 丁目 6 番 1 1 号第
一下谷ビル 8 F Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA,
BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN,
CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES,
FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN,
IR, IS, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS,
LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX,
MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH,
PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK,
SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW,
MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシ
ア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ
(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,
GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT,
NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: CARRIER FOR DOUBLE-SIDE POLISHING APPARATUS AND DOUBLE-SIDE POLISHING METHOD FOR
WAFER

(54) 発明の名称: 両面研磨装置用キャリア及びウェーハの両面研磨方法



(57) Abstract: The present invention pertains to a carrier for a double-side polishing apparatus, particularly, a carrier which is to be disposed between the upper and lower surface plates of a double-side polishing apparatus, both surface plates bearing abrasive cloths stuck thereon respectively, and which is provided with a holding hole for holding a wafer sandwiched between the upper and lower surface plates in polishing. This carrier for a double-side polishing apparatus is characterized in that the upper and lower principal faces of the carrier are made of a β -type titanium alloy prepared by incorporating pure titanium with at least 0.5wt% of a β -stabilizing element. Thus, a carrier which is for use in double-side polishing and which exhibits excellent wear resistance and enables a cost reduction is provided.

(57) 要約: 本発明は、両面研磨装置において、研磨布がそれぞれ貼付された上下定盤の間に配設され、研磨の際に前記上下定盤の間に挟まれたウェーハを保持するための保持孔が形成された両面研磨装置用キャリアであって、該キャリアの上下の主表面部は、純チタンに β 安定化元素を 0.5 重量%以上含有させた β 型チ

タン合金で構成されたものであることを特徴とする両面研磨装置用キャリアである。これにより、耐摩耗性に優れ、コストを低減可能な両面研磨用キャリアが提供される。